(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-33963

(43)公開日 平成6年(1994)2月8日

技術表示箇所	FΙ	庁内整理番号	識別記号	(51) Int.Cl. ⁶
		8917-3 J		F 1 6 F 1/32
		9152-4G		B 2 8 B 11/02
			301 A	C 0 4 B 38/00

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

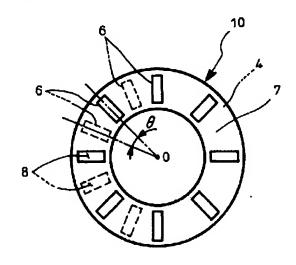
(21)出願番号	特顧平4-209628	(71)出顧人 000000099
		石川島播磨重工業株式会社
(22) 出顧日 工	平成4年(1992)7月14日	東京都千代田区大手町2丁目2番1号
		(72)発明者 杉田 孝志
		東京都江東区豊洲三丁目1番15号 石川島
		播磨工業株式会社技術研究所内
		(72)発明者 大橋 英雄
		東京都江東区豊洲三丁目1番15号 石川島
		播磨重工業株式会社技術研究所内
		(72)発明者 西 正輝
		東京都江東区豊洲三丁目1番15号 石川島
		播磨重工業株式会社技術研究所内
		(74)代理人 弁理士 山田 恒光 (外1名)
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 セラミック中空円盤積層ばねとその製造方法

(57)【要約】

【目的】 高温環境下で使用できるセラミック中空円盤 積層ばねとその製造方法を提供する。

【構成】 セラミック粉末とパインダとを混練して形成 したセラミック中空円盤4と、周方向等間隔位置に半径 方向に延びるスリット6を有し且つ該スリット6に前記 セラミック中空円盤4と同材質のセラミックリプ8を嵌 め込んだプラスチック中空円盤7とを、前記セラミック リプ8の露出面に溶媒を塗布した上で前記セラミック中 空円盤4を挟んで隣接するプラスチック中空円盤7相互 のスリット6が周方向に互い違いにずれるよう複数層交 互に積み重ねて積層体10を構成し、該積層体10を適 度な加圧力で平坦に押さえながら乾燥させ、次いで、前 記プラスチック中空円盤7及びパインダ類を加熱により 気化分解し、然る後、前記セラミック中空円盤4及びセ ラミックリプ8を焼成する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 積層された複数のセラミック中空円盤間 に、該セラミック中空円盤の周方向に等間隔で配置され 且つ積層方向にセラミック中空円盤を挟んで隣接する相 互が互い違いとなるよう周方向に所要角度ずらして配置 した複数のセラミックリブを備えてなることを特徴とす るセラミック中空円盤積層ばね。

【請求項2】 セラミック粉末とパインダとを混練して 形成したセラミック中空円盤と、周方向等間隔位置に半 ラミック中空円盤と同材質のセラミックリブを嵌め込ん だ有機質中空円盤とを、前記セラミックリプの露出面に 溶剤を塗布した上で前記セラミック中空円盤を挟んで隣 接する有機質中空円盤相互のスリットが周方向に互い違 いにずれるよう複数層交互に積み重ねて積層体を構成 し、該積層体を適度な加圧力で平坦に押さえながら乾燥 させ、次いで、前配有機質中空円盤及びパインダ類を加 熱により気化分解し、然る後、前記セラミック中空円盤 及びセラミックリブを焼成することを特徴とするセラミ ック中空円盤積層ばねの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、セラミック中空円盤積 層ばねとその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、エンジニアリング部門におけるセ ラミック材料の利用が注目を集めており、該セラミック 材料の有する耐熱性、耐食性、耐摩耗性に優れるという 性質からセラミック製ガスターピンやセラミック製ター ポチャージャー等の開発が進められている。

【0003】前記セラミック製ガスターピンやセラミッ ク製ターポチャージャー等を実現する為には、苛酷な高 温条件にさらされるセラミック構造体同士の間、或いは セラミック構造体と金属構造体との間に、熱膨張、熱衝 撃等を緩和する為の応力緩衝部材を使用する必要があ る。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来か らある金属製ばねでは、例えば1000℃以上の高温環 ガスターピンやセラミック製自動車エンジン等を実現す る上での障害となっていた。

【0005】本発明は上述の実情に鑑みてなしたもの で、高温環境下で使用できるセラミック中空円盤積層は ねとその製造方法を提供することを目的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に記載 の発明は、積層された複数のセラミック中空円盤間に、 該セラミック中空円盤の周方向に等間隔で配置され且つ

互い違いとなるよう周方向に所要角度ずらして配置した 複数のセラミックリブを備えてなることを特徴とするセ ラミック中空円盤積層ばね、に係るものであり、本発明 の請求項2に記載の発明は、セラミック粉末とパインダ とを混練して形成したセラミック中空円盤と、周方向等 間隔位置に半径方向に延びるスリットを有し且つ該スリ ットに前記セラミック中空円盤と同材質のセラミックリ プを嵌め込んだ有機質中空円盤とを、前記セラミックリ ブの露出面に溶剤を塗布した上で前記セラミック中空円 径方向に延びるスリットを有し且つ該スリットに前配セ 10 盤を挟んで隣接する有機質中空円盤相互のスリットが周 方向に互い違いにずれるよう複数層交互に積み重ねて積 層体を構成し、該積層体を適度な加圧力で平坦に押さえ ながら乾燥させ、次いで、前記有機質中空円盤及びパイ ンダ類を加熱により気化分解し、然る後、前配セラミッ ク中空円盤及びセラミックリブを焼成することを特徴と するセラミック中空円盤積層ばねの製造方法、に係るも のである。

[0007]

【作用】従って本発明の請求項1に記載のセラミック中 20 空円盤積層ばねによれば、セラミック中空円盤の周方向 複数箇所が隣接する各層において互い違いに弾性変位可 能であることから全体として積層方向に均等なばね定数 を有するばねとして機能する。

【0008】このセラミック中空円盤積層ばねは、全て の構成が耐熱性に優れたセラミック材料である為、高温 環境下で使用することが可能で、各セラミック中空円盤 の間に空隙を隔てた多層構造となっているので断熱効果 が高く、しかも各セラミック中空円盤及び各セラミック リブが薄肉構造となっているので熱応力も低い。

【0009】又、本発明の請求項2に記載のセラミック 中空円盤積層ばねの製造方法によれば、前記セラミック 中空円盤積層ばねが極めて容易に製作され、しかも、後 加工の不要な完成品として得られる。

[0010]

30

【実施例】以下本発明の実施例を図面を参照しつつ説明

【0011】図1~図6は本発明の一実施例を示すもの である。

【0012】図1に示す如く、セラミック粉末1とメチ 境下で使用できるようなものがなく、前配セラミック製 40 ルセルロース等のパインダ2とを混練してシート状に押 出し成形したセラミックシート3を打抜き加工すること によりセラミック中空円盤4を形成する。

> 【0013】又、図2に示す如く、プラスチックシート 5を打抜き加工することにより周方向等間隔位置に半径 方向に延びるスリット6を有するプラスチック中空円盤 7を形成し、前配スリット6には前配セラミック中空円 盤4と同材質のセラミックリブ8を嵌め込む。

【0014】ここで、前記プラスチック中空円盤7の中 心口から前記スリット6の外側端までの寸法 r1と前記 積層方向にセラミック中空円盤を挟んで隣接する相互が 50 中心Oから前記スリット6の内側端までの寸法 r_2 は、

3

夫々前記セラミック中空円盤4の外径R1と内径R2と等 しくなるようにしておく。

【0015】次いで、図3に示す如く、前配セラミックリブ8の露出面8aに水等の溶剤9を整布した上で、図4に示す如く、前記セラミック中空円盤4とプラスチック中空円盤7とを複数層交互に積み重ねて積層体10を構成し、該積層体10を押え板11,11により適度な加圧力で平坦に押さえることによって、前記セラミックリブ8とセラミック中空円盤4とを接合して積層体10を一体化する。

【0016】この際、前配セラミック中空円盤4を挟んで隣接するプラスチック中空円盤7相互のスリット6が、図5に示す如く周方向に互い違いに6角度ずれるよう配置して積層体10を構成する。例えば、図示の例では1枚のプラスチック中空円盤7に8個のスリット6を等間隔に形成しているので、隣接するプラスチック中空円盤7相互を22.5度ずつ角度をずらして積層する。

【0017】次いで、図4の状態のまま前記積層体10 を押え板11,11により適度な加圧力で平坦に押さえ ながら加熱して乾燥させた後、図示しない大気雰囲気の 20 加熱炉等に入れて800℃程度に加熱することによっ て、前記プラスチック中空円盤7と、セラミック中空円 盤4及びセラミックリブ8に含まれるパインダ2類を気 化分解して除去し、然る後、図示しない不活性雰囲気の 別の加熱炉等に入れて前配より更に高温(セラミックが アルミナの場合は1500℃程度・窒化珪素の場合には 1800℃程度)で加熱し、前配セラミック中空円盤4 及びセラミックリブ8を焼成すると、図6の周方向断面 展開図に示されるように、焼成されて籾性を得たセラミ ック中空円盤4の周方向複数箇所が隣接する各層におい 30 て互い違いに弾性変位可能となり、全体として積層方向 に均等なばね定数を有するセラミック中空円盤積層ばね 12が製作される。

【0018】以上の如くして製作されたセラミック中空 円盤積層ばね12は、全ての構成が耐熱性に優れたセラ ミック材料である為、高温環境下で使用することが可能 であり、苛酷な高温条件にさらされるセラミック構造体 同士の間、或いはセラミック構造体と金属構造体との間 に、熱膨張、熱衝撃等を緩和する為の応力緩衝部材とし て使用することができる。

【0019】更に、前配セラミック中空円盤積層ばね1 2は、各セラミック中空円盤4の間に空隙を隔てた多層 構造となっているので、断熱効果が高く、例えば温度差 のあるセラミック構造体と金属構造体との間に用いる場 合等に有用性が高い。

【0020】又、前記セラミック中空円盤積層ばね12は、各セラミック中空円盤4及び各セラミックリブ8が 等肉構造となっているので熱応力が低く、耐久性が高い

【0021】更に、前記セラミック中空円盤積層ばね1 50

2は、セラミック中空円盤4の積層枚数を変えることにより任意にばね剛性を設定することができるので、ばね 剛性の設計が極めて容易である。

【0022】又、以上に述べた製造方法によれば、前記の如き種々の効果を有するセラミック中空円盤積層ばね12を極めて容易に製作することができるので量産性が高く、しかも、後加工の不要な完成品として得ることができるので製作コストが低い。

【0023】尚、本発明のセラミック中空円盤積層ばね 10 とその製造方法は、上述の実施例にのみ限定されるもの ではなく、セラミック中空円盤の積層数及びセラミック リブの設置数は図示の例に限定されないこと、有機質中 空円盤の材質はプラスチック以外に加熱により容易に気 化分解可能な有機質材料であれば良く、例えば紙等を用 いても良いこと、セラミックリブ(スリット)の形状は 長方形以外でも良いこと、その他、本発明の要旨を逸脱 しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論で ある。

[0024]

【発明の効果】上記した本発明のセラミック中空円盤積 層ばねとその製造方法によれば、下記の如き種々の優れ た効果を奏し得る。

【0025】(I)本発明の請求項1に記載のセラミック中空円盤積層ばねは、全ての構成が耐熱性に優れたセラミック材料である為、高温環境下で使用することが可能であり、苛酷な高温条件にさらされるセラミック構造体同士の間、或いはセラミック構造体と金属構造体との間に、熱膨張、熱衝撃等を緩和する為の応力緩衝部材として使用することができる。

0 【0026】(II)本発明の請求項1に記載のセラミック中空円盤積層ばねは、各セラミック中空円盤の間に空隙を隔てた多層構造となっているので、断熱効果が高く、例えば温度差のあるセラミック構造体と金属構造体との間に用いる場合等に有用性が高い。

【0027】(III) 本発明の請求項1に記載のセラミック中空円盤積層ばねは、各セラミック中空円盤及び各セラミックリブが蒋肉構造となっているので熱応力が低く、耐久性が高い。

【0028】(IV)本発明の請求項1に記載のセラミ 40 ック中空円整積層ばねは、セラミック中空円盤の積層枚 数を変えることにより任意にばね剛性を設定することが できるので、ばね剛性の設計が極めて容易である。

【0029】(V)本発明の簡求項2に記載の製造方法によれば、前配(I)~(IV)の如き種々の効果を有するセラミック中空円盤積層ばねを極めて容易に製作することができるので量産性が高く、しかも、後加工の不要な完成品として得ることができるので製作コストが低い

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例におけるセラミック中空円盤

5

の平面図である。

【図2】本発明の一実施例におけるプラスチック中空円 盤の平面図である。

【図3】図2のプラスチック中空円盤のスリットに嵌め 込んだセラミックリプの拡大斜視図である。

【図4】本発明の一実施例における積層体の一部を切り 欠いて示す側面図である。

【図 5】隣接するプラスチック中空円盤相互の積層状態を示す平面図である。

【図6】本発明の一実施例におけるセラミック中空円盤 10 12 積層ばねの周方向断面の展開図である。

【符号の説明】

1 セラミック粉末

2 パインダ

4 セラミック中空円盤

6 スリット

7 プラスチック中空円盤

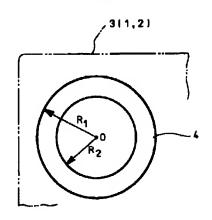
8 セラミックリプ

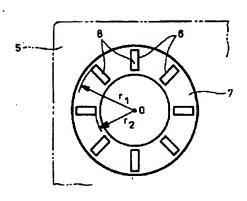
9 溶剤

10 積層体

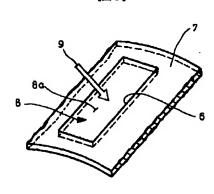
12 セラミック中空円盤積層ばね

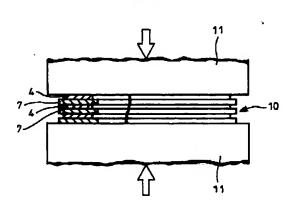
[図1] [図2]





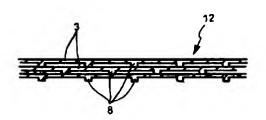




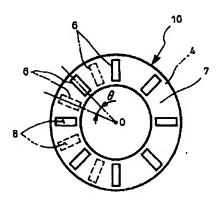


[図4]

【図6】



【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 宮原 薫

東京都江東区豊洲三丁目 1 番15号 石川島 播磨重工業株式会社技術研究所内

